

仕 様 書

1. 件名

ソフトウェア

2. 研究の概要

国立研究開発法人産業技術総合研究所 量子・AI 融合技術ビジネス開発グローバル研究センターでは、超伝導集積回路の研究を行っている。

3. ソフトウェアの概要

本ソフトウェアは、超伝導集積回路の回路図、レイアウト図、シンボルの作成及び設計を行うためのツールである。

4. ソフトウェアの仕様

- ① Linux OS 上で操作できること
- ② SSH 等のリモート操作により使用できること
- ③ ライセンス期間は 2023 年 11 月より 1 年間とすること
- ④ 基本的な回路シンボル (R、L、C、電源、GND 等) を配置することで回路図を作成できること
- ⑤ 任意形状の回路シンボルを定義できること
- ⑥ 基本的な二次元パターン (四角、ポリゴン、パス等) を配置することで集積回路のレイアウト図を作成できること
- ⑦ 任意の集積回路レイヤー構成を定義できること
- ⑧ 同時に 3 人以上のユーザーが回路図及びレイアウト図を設計できること
- ⑨ 回路図及びレイアウト図の設計効率化のため、素子の移動及びコピーを行うキーボードショートカットを有すること
- ⑩ デザインルールチェックを実行できること
- ⑪ ユーザーによりデザインルールを定義できること
- ⑫ 回路図、レイアウト図、シンボルを 1 つの回路セルとして管理できること
- ⑬ 回路図及びレイアウト図作成の際に、他の回路セルをインスタンスとして利用できること
- ⑭ レイアウト図作成の際に、インスタンスを等間隔に配置する機能を有すること
- ⑮ ユーザーがスクリプトやプログラミングを用いずに、階層的なライブラリ構造を管理できるインターフェースを有すること

- ⑯ GDS ファイルのインポート及びエクスポートができること
- ⑰ 設計資産を利用するため、SKILL 言語によるプログラミングが可能であること

5. 特記事項

サプライチェーン・リスクに対応するため、「IT 調達に係る国等の物品等又は役務の調達方針及び調達手続きに関する申合せ」(平成 30 年 12 月 10 日関係省庁申合せ)に基づき対応を求めることがあるので応じること。

7. 納入物品

ソフトウェア (ライセンス) 一式

8. 納入の完了

本装置は、「7. 納入物品」に記載された納入物品が過不足なく納入され、仕様を満たしていることを確認して、納入の完了とする。

9. 納入期限及び納入場所

納入期限：2023 年 10 月 31 日

納入場所：茨城県つくば市梅園 1-1-1

国立研究開発法人産業技術総合研究所

量子・AI 融合技術ビジネス開発グローバル研究センター

中央事業所 2 群 2-1D 棟 D-511-2

10. 付帯事項

- (1) 受注者は、業務上知り得た一切を産総研の許可なく他に漏らしてはならない。また、他の目的に利用してはならない。本件で調達するソフトウェアライセンスの使用予定期間終了後も同様とする。
- (2) 本仕様書の技術的内容に関する質問等については、調達請求者と協議すること。また、本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、調達担当者と協議のうえ決定する。